

## Erfolgreiches Risikomanagement bei der SCHWEIZER ELECTRONIC AG

*Das, auch von Kunden bestätigte, erfolgreiche Risikomanagement der SCHWEIZER ELECTRONIC AG zeigt sich heute beim Besuch des Unternehmens. Neue Anlagen stehen oder werden installiert. Der Neubau des zerstörten Gebäudeteiles hat begonnen.*

Bereits wenige Tage nach dem Großbrand am 1. Juni 2005 stand der Masterplan für den Wiederaufbau. In enger Abstimmung mit den Sachverständigen der Versicherungen wurde eine Provisorienstrategie umgesetzt, die zum Ziel hatte, die Fertigung so schnell als möglich wieder hochzufahren.

Inzwischen hat es sich gezeigt, dass dieser Weg richtig war. SCHWEIZER konnte dadurch den Kontakt zu den Kunden halten und diese weiterhin beliefern.

Räumliche Ausweichmöglichkeiten nach dem Brand boten das Werk im 8 km entfernten Dunningen sowie das erst teilweise genutzte Hochtechnologiewerk in Schramberg, das beim Brand nicht beschädigt wurde. Dorthin wurde einige der verbliebenen Anlagen verlagert, so dass die Produktion schnell wieder aufgenommen werden konnte. In diesem Werk findet nun auch überwiegend der Wiederaufbau nach dem Masterplan der SCHWEIZER ELECTRONIC AG statt.

Gleich nach dem Brand wurde der elektrische Test in das Werk Dunningen verlagert. Dort befindet sich

die HAL-Anlage, die bei Bedarf auch für HAL bleifrei benutzt wird und zuverlässig den größten Teil der Endoberflächen produziert. Somit ist es im Werk Dunningen zwar etwas enger geworden, entscheidend ist jedoch, dass die Fertigung schnell wieder aufgenommen werden konnte.

SCHWEIZER kann schon heute wieder die Oberflächen chemisch Zinn und chemisch Nickel-Gold anbieten. Die beiden Anlagen wurden bereits um die Jahreswende qualifiziert. Da nicht nur die eingesetzten Prozesse, sondern letztlich auch die Anlagen mit den bisher verwendeten Anlagen und Fertigungsabläufen identisch sind, war das Risiko für den Wiederanlauf gering.

Die Qualifizierung nach TS 16949 für chemisch Zinn ist bereits abgeschlossen und die vorhandene Kapazität entspricht dem Masterplan für den Wiederanlauf.

Kurz nach der Anlage für chemisch Zinn konnte der Automat für chemisch und galvanisch Nickel-Gold aufgebaut werden. Die Anlage, die dem bewährten Entwurf der zerstörten Anlage entspricht, ist zurzeit in der Qualifikationsphase. Auch hier entsprechen die neu gewonnenen Kapazitäten der Planung.

Ein entscheidender Schritt wird die nun begonnene Qualifizierung des neuen PAL-Galvanoautomaten in Vertikaltechnologie sein. Wie geplant trafen die fast 30 Container aus Hongkong nach der Bestellung im August am 13. Januar in Deutschland ein. In einer generalstabsmäßigen Aktion kamen die Container an mehreren Tagen in Schramberg an und wurden von einem fast 30 Mann starken chinesischen Aufbaukommando



Chemisch Zinn-Linie, im Hintergrund Nickel-Gold-Linie

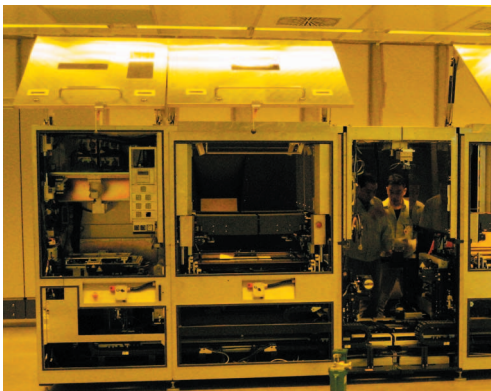
unter schottischer Führung ausgeladen und in einen Galvanoautomaten verwandelt. Die Inbetriebnahme erfolgte ab Ende März. Derzeit laufen die ersten Testnutzen für eine ausführliche Qualifikation entsprechend den Regeln der TS 16949. Die ersten



Der Galvanoautomat in der Anfangsphase (18.1.2006)



PAL-Galvanoautomat gegen Bauende



Blick in den Belichter der neuen Leiterbildlinie

Ergebnisse sind ausgezeichnet und bestätigen das erwartete, positive Bild des neuen „Arbeitspferdes“ der *SCHWEIZER ELECTRONIC AG*. Mit einem umbauten Raum von 2815 m<sup>3</sup>, einer Länge von 68 m und einer Höhe von 9 m fasst er 18 Bäder. Die gerade begonnen Fertigungsfreigabe wird in enger Abstimmung mit allen Kunden durchgeführt. Hier hofft *SCHWEIZER* auf eine zügige Freigaben durch die Kunden.

Im Hochtechnologiewerk werden momentan direkt neben der bereits bestehenden Innenlagenlinie zwei Leiterbildlinien als Ersatz für die zerstörten Anlagen installiert. Eine Linie ist zur Bearbeitung von Innenlagen und die andere vorrangig für Außenlagen vorgesehen. Auch dieser Aufbau ist voll im Zeitplan. Ab Mai 2006 wird *SCHWEIZER* erste Muster aus der neuen Innenlagenlinie zur Freigabe durch die Kunden liefern. Im Juli folgen dann die Freigabemuster für die Außenlagenlinie.

Neben den eigentlichen Fertigungsanlagen werden alle notwendigen Einrichtungen zu Umwelt-, Klima- und Lüftungstechnik ergänzt, um eine sichere Produktion gewährleisten zu können.

Da auch einige unterstützende Abteilungen wie das Qualitätswesen und die Arbeitsvorbereitung vom Brand betroffen waren, mussten diese verlagert werden. Sie fanden ihr Provisorium im zweiten Stock des Logistikbereiches und haben nun den Vorteil etwas kürzerer Wege in die Fertigungsbereiche des Hochtechnologiewerkes.

Auch im Außenbereich tut sich etwas. Der beschädigte Gebäudeteil ist abgerissen und der Neubau wurde begonnen. Der Spatenstich fand trotz Schnee statt und der Stahlbau wird in den nächsten Tagen begonnen werden. Die Bezugfertigkeit für das neue Gebäude mit einer Fläche von ca. 4600 m<sup>2</sup> ist für Ende 2006 geplant.

Um die Menge an zu installierenden Fertigungsanlagen und sonstiger Betriebseinrichtungen zu schaffen, hat die *SCHWEIZER ELECTRONIC AG* ehemalige Fertigungsmitarbeiter in der Anlageninstandhaltung ausgebildet, die die Stammmannschaft unterstützen. So kann der Einsatz externer Unternehmen minimiert werden; dieser ist aber nicht ganz zu vermeiden.

Um die vielen Anforderungen an die Qualifikation gemäß QS 9000 und TS 16949 erfüllen zu können,



Die 3 Vorstände und der Projektleiter beim Spatenstich (von links): Bernfried Fleiner, Leiter Industrial Engineering und Projektleiter; Rainer Hartel, Vorsitzender des Vorstands; Rudolf Schmider, Vorstand; Dr. Marc Schweizer, Vorstand



Erste Teile des Stahlbaus werden aufgebaut

wurden von der *SCHWEIZER ELECTRONIC AG* weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Fertigung im Qualitätswesen für die Hochlaufphase eingesetzt. Diese Kolleginnen und Kollegen werden durch Schulungen auf diese wichtige Aufgabe vorbereitet. So können nicht nur die Tests, sondern dann auch die erforderlichen Auswertungen zügig durchgeführt werden. Nur so können den Kunden die erforderlichen Unterlagen nach APQP oder PPAP zur Verfügung gestellt werden.

Am Ende der Hochlaufphase gehen diese Mitarbeiter aus dem Qualitätswesen und der Anlageninstandhaltung wieder in die Fertigung zurück und haben dann ihr Wissen deutlich verbessert. Diese

Investition in das Wissen der Mitarbeiter wird sich sicherlich auszahlen.

Bisher konnte der Zeitplan trotz des langen Winters gehalten werden. Insgesamt werden in den nächsten Monaten mehrere größere Anlagen und viele kleine Maschinen wieder aufgebaut oder von Experten saniert und dann durch die *SCHWEIZER ELECTRONIC AG* wieder für die Produktion freigegeben sein.

Die *SCHWEIZER ELECTRONIC AG* wird auch den restlichen Wiederaufbau, wie geplant, Mitte 2007 abgeschlossen haben – dank seiner erfahrenen Mitarbeiter, die zu einem großen Teil erfolgreich die Mehrebenenqualifikation durchlaufen haben.

-dir/hb-

#### **Kontaktadresse**

SCHWEIZER ELECTRONIC AG, Einsteinstraße 10, 78713 Schramberg,  
Tel. 07422/512-0, Fax -398, seag@seag.de, www.seag.de

**P  
L  
U  
S**